

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	浙商证券等 145 人
时间	2024 年 8 月 22 日 21:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云 证券事务代表：李志鹏
投资者关系活动记录	<p>公司就近期市场波动的情况说明：</p> <p>公司目前生产经营正常，其中硅片业务、化合物半导体射频芯片业务呈现较好增长趋势，出货量、营收将创出历史新高，功率半导体芯片业务保持稳定；公司目前现金流情况乐观、经营性净现金流充沛、银行授信储备充足、资产负债率不高、未来资本支出可控；公司目前不存在应披露而未披露的信息。</p> <p>一、公司可转债概况</p> <p>公司于 2022 年 11 月 18 日公开发行可转换公司债券 33,900,000 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 339,000.00 万元，期限 6 年（即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日），债券票面年利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。到期赎回价格为 112 元（含最后一期利息）。</p> <p>与可转债相关的有关指标介绍如下：</p> <p>1. 公司目前现金流充裕。公司所属的业务领域属于重投资行业，当前公司固定资产原值超 100 亿元、设备折旧年限为 10 年，每年计提的折旧费用较大。此外，半导体行业属于新质生产力，公司每年获得的政府补助金额较大。</p>

2.公司银行授信额度充足。当前公司及各控股子公司银行授信超过 86 亿元，实际使用的比例大概在 40%左右，可满足公司资金需求。

3.公司货币资金充裕。公司第一季度报告披露的货币资金约 26 亿元，目前无明显的变化。

4.公司目前在建工程所需的资本支出节奏可控。公司目前有四个投资额较大的在建项目，其中“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片”和“年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片”属于可转债募投项目，建设进度延期至 2026 年 5 月。嘉兴金瑞泓年产 480 万片 12 英寸大硅片项目立项总投资约 60 亿元，但第一阶段 15 万片/月的投资到今年年底将告一段落，后续将根据市场需求、公司产能爬坡情况审慎投资。海宁东芯 36 万片射频集成电路芯片项目总投资约 50 亿元，但第一阶段的年产 6 万片/月的投资也将在今年年底建成，后续将根据市场需求、公司产能爬坡情况审慎投资。公司将兼顾公司发展和股东回报，不会盲目扩产。

5.公司资产负债率不高。公司目前资产负债率约 51%，剔除可转债的资产负债率约 40%。

6.公司债券评级稳定。公司评级机构延续公司可转债“AA”的评级，较公司可转债发行时未发生变化。

7.公司 8 月 22 日收盘的可转债的价格与到期赎回价格 112 元相比，年平均收益率已达到约 10%，具有较好的投资价值。

二、公司近期业务概况

半导体行业在今年第二季度呈现复苏态势，据数据显示，2024 年第二季度全球半导体产业销售额较去年同比增长 18.3%，较今年一季度实现 6.5%的环比增长。2024 年 6 月全球半导体销售额同比增长 22.9%，环比增长 1.7%，已连续 8 个月同比增长；其中中国半导体销售额同比增长 21.6%，环比增长 0.8%。具体到公司而言：

（一）硅片业务板块

1. 行业趋势：从今年以来的订单情况来看，半导体硅片细分行业开始见底回升，当前国内硅片的需求旺盛，产能利用率迅速回升。大硅片的国产化替代正在稳步推进，公司 12 英寸硅片产品爬坡进度有望加快。

2. 出货量：2024 年上半年折合 6 英寸的半导体硅片销量为 668.85 万片（含对立昂微母公司的销量 99.45 万片），同比增长 46.22%，环比增长 26.94%，其中 12 英寸硅片销量

40.75 万片（折合 6 英寸为 163 万片），同比增长 89.63%，环比增长 43.65%；分季度看，2024 年第二季度折合 6 英寸的半导体硅片销量为 357.67 万片（含对立昂微母公司的销量 57.48 万片），环比增长 14.94%，其中 12 英寸硅片销量 23.61 万片（折合 6 英寸为 94.44 万片），环比增长 37.75%。（具体见公司披露的《立昂微 2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024-065），下同）

目前 6 英寸、8 英寸外延片产能利用满载，出现交货延迟的情况；12 英寸硅片出货量快速爬坡，出货量屡创新高。

3.硅片价格：6-8 英寸硅片受产能紧张、产品结构调整等因素的影响，2024 年第二季度以来平均出货价格环比上升，产品价格开始进入上升趋势，新订单已经开始涨价。其中厚外延硅片的占比提高，其单片的附加值更高。12 英寸硅片价格保持稳定。

4.产能

6 英寸抛光片（含衬底片）产能 60 万片/月、8 英寸抛光片（含衬底片）产能 27 万片/月（预计 2024 年 10 月份达到 57 万片/月）、6-8 英寸（兼容）外延片产能 70 万片/月（预计 2024 年 12 月底达到 90 万片/月）；衢州基地 12 英寸抛光片（含衬底片）产能 15 万片/月、12 英寸外延片产能 10 万片/月；嘉兴基地 12 英寸抛光片产能 8 万片/月，预计 2024 年年底达到 15 万片/月。

（二）功率器件芯片业务板块

2024 年上半年半导体功率器件芯片销量 90.16 万片，同比增长 4.96%，环比增长 5.22%；其中第二季度 48.28 万片，环比增长 15.30%。

目前设备产能约为 23.5 万片/月，产品价格目前已经企稳。公司功率器件芯片产品结构中，光伏有关产品的出货量占 60%左右，新能源汽车相关需求占 20%左右，另外 20%为储能、工控、消费电子等有关。

（三）化合物半导体射频芯片业务板块

2024 年上半年化合物半导体射频芯片销量 1.76 万片，同比增长 288.18%，环比增长 31.84%。

1. 技术情况：技术水平进入全球第一梯队行列。开发了二维可寻址 VCSEL 工艺技术，成为行业内首家量产二维可寻址激光雷达 VCSEL 芯片的制造厂商。

2.客户验证情况：射频芯片产品基本覆盖国内主流手机芯片设计客户及其他应用端客户。产品同时进入低轨卫星终端客户实现大规模出货。

3.国产替代情况：受地缘政治的影响，射频芯片供应链逐步转向国内，射频芯片国产化替代进度加快。

4.产能情况：杭州基地目前经过扩产，产能约为 9 万片/年，海宁基地预计可于 2024 年第四季度投入商业运营，第一期产能约为 6 万片/年，预计第四季度可实现产出。

2024 年上半年射频芯片业务的毛利率已经转正，未来伴随产能利用率上升，我们对射频芯片业务的发展趋势持有非常积极乐观的态度。

三、财务指标介绍

公司财务指标具体详见公司 2024 年半年度业绩预告，具体财务数据公司将于 2024 年 8 月 29 日披露半年度报告。

公司认为半导体行业景气度已开始复苏，主要的原因在于新兴战略行业的需求快速增长，叠加国家对于新质生产力的支持，未来半导体产业将呈现持续向好的趋势。

四、投资者交流主要问题回复（部分问题合并至业务介绍中）

1. 公司整体营收中各业务板块的占比如何？展望未来业务发展中心在哪里？

答：硅片业务板块收入约占 60%，功率半导体芯片板块收入约占 31%，化合物半导体射频芯片收入约占 9%。今后公司重点业务方向将围绕 12 英寸硅片产品和化合物半导体射频芯片产能及产量提升，这两个业务板块到年底均有新增产能投产；功率半导体业务重点将聚焦产品结构的优化和产品附加值的提升。

2.公司半导体硅片是否有出口？

答：公司生产的硅片出口占比超 10%，出口产品主要为重掺硅片，公司重掺硅片产品技术在全球具有竞争力，客户主要来自日本、中国台湾、欧美、东南亚等地。

3.公司射频芯片的稳态毛利率大概有多少？

答：公司射频芯片产品出货量大幅增加叠加公司严格管控生产成本、加快原辅料的国产化替代带来单位生产成本的快速降低，上半年毛利率已转正并达到较好水平，我们对未来毛利率的继续上升趋势非常乐观。

4.公司 12 英寸硅片销量上涨主要源于哪些下游客户？

答：不同类型的客户（逻辑电路、存储电路、功率半导体、模拟电路）均有上涨。

5.公司硅片业务后续扩产的建设是否会引入少数股东？是否考虑大基金三期？

答：感谢投资者建议，公司将认真考虑。

6.在必要时候，公司控股股东是否会给予公司财务支持？

	<p>答：如前所述，公司财务状况良好、拥有足够的偿债能力，无需大股东财务支持。当然公司控股股东实力雄厚，如果公司有需求肯定会伸出援手。公司在未来的发展中会朝着已确定的发展战略方向逐步去达到目标，绝不会不顾公司自身的现金流能力，去做一些不切实际的扩张。</p> <p>7.公司衢州 12 英寸工厂何时达到盈亏平衡点？</p> <p>答：预计出货量（正片）达到全年产能的 70%以上可以达到盈亏平衡。</p>
<p>资料清单 (如有)</p>	<p>无</p>